



公益社団法人応用物理学会 応用電子物性分科会主催

応用電子物性分科会研究例会

## 光電融合技術の最前線

◇日時: 2026年3月5日(木) 13:10~17:05

◇場所: 御茶ノ水トライエッジカンファレンス(<https://try-edge.infield95.com/access/>)

近年、データセンターやAI処理の急速な進展に伴い、電子回路と光通信を融合させる「光電融合技術」が注目を集めています。シリコンフォトニクスや異種材料の集積技術、光電変換デバイスなどは、超高速・低消費電力の情報処理を実現する鍵です。さらに、デバイスの高集積化に伴う熱問題への対応として、フォノンエンジニアリングによる熱制御技術も重要な役割を果たします。本研究例会では、これらの分野で先駆的研究を展開されている研究者をお迎えし、基盤技術から応用展開まで幅広く議論します。ぜひご参加ください。

-----  
応用電子物性分科会 幹事長 挨拶 (13:10-13:20)

- 13:20-14:00 光電融合に向けた異種材料集積フォトニクス 竹中 充 (東京大学)
- 14:00-14:40 IOWNと光電融合 才田 隆志 (NTT)
- 14:40-15:20 Co-Packaged Optics用小型光トランシーバ 那須 秀行 (古河電工)
- 休憩 (15:20-15:40)
- 15:40-16:20 高速シリアル伝送を支えるEMLと実装技術 白尾 瑞基 (三菱電機)
- 16:20-17:00 半導体デバイスの熱マネジメントに重要な物理と熱制御技術の最前線 野村 政宏 (東京大学)

閉会 (17:00-17:05)  
-----

■受付: 以下のイベント登録webページより事前登録をお願いいたします。

[https://eventpay.jp/event\\_info/?shop\\_code=3672191893354666&EventCode=C845471552](https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3672191893354666&EventCode=C845471552)

■参加費(テキスト代・消費税込):

応用電子物性分科会会員 3,000 円, 応用物理学会会員(分科会非会員) 7,000 円

応用物理学会会員(シニア会員) 2,000 円, 一般 12,000 円, 一般学生 1,000 円

\*応電分科会の賛助会員の方は 1 社につき 1 名まで無料。2 名以上は通常通りの参加費。

\*応電分科会幹事は無料。

■問合せ先: 山口 敦史(金沢工大) E-mail: yamaguchi@neptune.kanazawa-it.ac.jp  
谷保 芳孝(NTT) E-mail: yoshitaka.taniyasu@ntt.com  
横関弥樹博(ソニーセミコンダクタソリューションズ) E-mail: Mikihiro.Yokozeki@sony.com  
松浦 雅広(三菱電機) E-mail: Matsuura.Masahiro@bx.MitsubishiElectric.co.jp  
吉田千秋(応用物理学会 事務局) TEL: 03-3828-7723(直通) E-mail: divisions@jsap.or.jp  
(スパム対策のため、上の“@”は全角になっています。半角の“@”に置き換えて下さい。)  
応用電子物性分科会ホームページ: <http://annex.jsap.or.jp/ohden/>